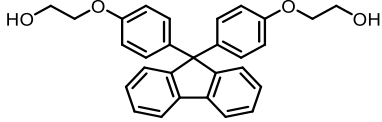
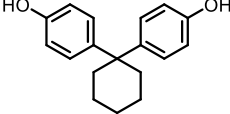
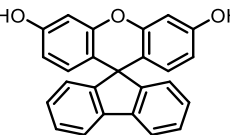
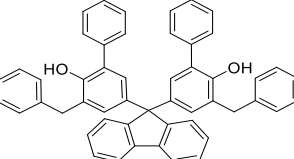


# TBIS<sup>®</sup> series Products List

## ビスフェノール誘導体

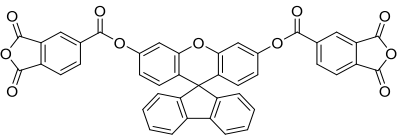
近年進む高性能・高機能化のニーズに応じるため、当社では種々のビスフェノール誘導体の開発・生産を行っています。これら化合物群は透明性や耐熱性が必要な樹脂原料に適しており、特にフルオレン系化合物はカルド構造を有することで高屈折率、低複屈折といった特徴を示します。

化学名[品名]	構造	代表性状等	Stage
<b>TBIS<sup>®</sup> -G</b>		CAS No. 117344-32-8 化審法 4-1718 外観 白色結晶 融点 164℃ 屈折率 1.62	Commercial
<b>CHBP-F</b>		CAS No. 843-55-0 化審法 4-44 外観 白色結晶 融点 194℃ 屈折率 1.59	Commercial
<b>TBIS<sup>®</sup> -RX</b>		CAS No. 4081-00-9 化審法 - 外観 白色結晶 融点 270℃ 屈折率 1.65	Pilot
<b>TBIS<sup>®</sup> -ZP</b>		CAS No. 2115022-46-1 化審法 - 外観 白色結晶 融点 203℃ 屈折率 1.67	Pilot

【用途】 特殊樹脂(光学材料、電子材料)原料、改質剤

## 酸二無水物誘導体

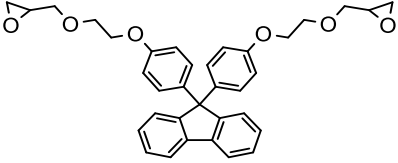
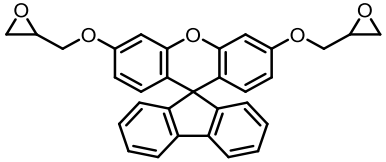
フルオレン骨格を含む特殊構造により、耐熱性、高透明性を示します。ポリイミド・ポリアミド原料、エポキシ樹脂用硬化剤、ウレタン用架橋剤など様々な用途としての利用が期待できます。

化学名[品名]	構造	代表性状等	Stage
<b>TBIS<sup>®</sup> -RXN</b>		CAS No. 1830316-18-1 化審法 - 外観 白色結晶 融点 332℃ 屈折率 1.63	Laboratory

【用途】 ポリイミド・ポリアミド原料、エポキシ樹脂用硬化剤、ウレタン用架橋剤

## エポキシ樹脂

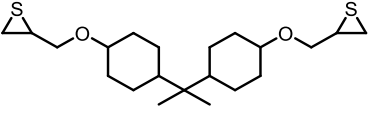
フルオレン骨格を含む特殊構造により、耐熱性に優れ、高透明性を示します。また、既存のビスフェノールフルオレンエポキシ樹脂と比較して、高屈折率に優れる上、溶媒溶解性が高くハンドリング性に優れているといった特徴があります。

化学名[品名]	構造	代表性状等	Stage
<b>TBIS<sup>®</sup>-GG</b>		CAS No. 259881-39-5 化審法 4-1816 外観 淡黄色粘性固体 5%重量減少温度 363.4℃ 粘度(150℃) 52.5mPa·s 屈折率 1.60	pilot
<b>TBIS<sup>®</sup>-RXG</b>		CAS No. 47769-72-2 化審法 - 5%重量減少温度 342℃ 粘度(150℃) 374mPa·s 屈折率 1.62	Laboratory

【用途】 電子材料(レジスト、封入剤)、光学材料、接着剤、塗料、積層剤、添加剤等

## エピスルフィド樹脂

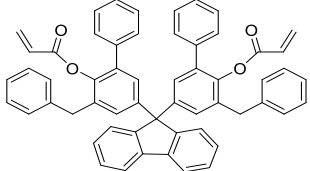
TBIS<sup>®</sup>-AHSPは低温で硬化する特徴を有しています。また、その硬化物は低誘電特性、低吸水性といった性質を持ち、硫黄化合物特有の臭気も低く、透明性に優れた物が得られます。

化学名[品名]	構造	代表性状等	Stage
<b>TBIS<sup>®</sup>-AHSP</b>		CAS No. 2489336-20-9 化審法 - 外観 無色～淡黄色粘性液体 粘度(25℃) 30Pa·s 屈折率 1.53	pilot

【用途】 偏光版向け接着剤、有機EL・LED封止剤および接着剤など

## アクリレート

TBIS<sup>®</sup>-ZPCはフルオレン骨格を有するアクリルモノマーであり、高屈折率を達成しながらも、高い溶剤溶解性を有します。常温での保存安定性にも優れており、溶液中でも結晶化せずに安定的に取り扱うことができます。

化学名[品名]	構造	代表性状等	Stage
<b>TBIS<sup>®</sup>-ZPC</b>		CAS No. 2115022-49-4 化審法 - 外観 無色～淡黄色固体 透明性 T <sub>400</sub> 90.4% 屈折率 1.63	pilot

【用途】 電子材料、光学材料、添加剤等